



主要特点

通道数目: 5

通带频率: 2 - 6 GHz

2.2 - 2.8 GHz

2.7 - 3.7 GHz

3.6 - 5.1 GHz

5 - 5.9 GHz

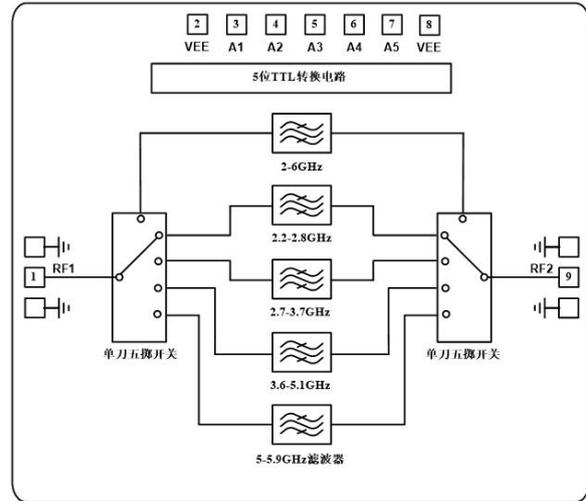
输入 P1dB: 26dBm

控制电压: 0 / +5 V

供电: -5 V @ 7 mA

芯片尺寸: 3 × 4 × 0.1 mm³

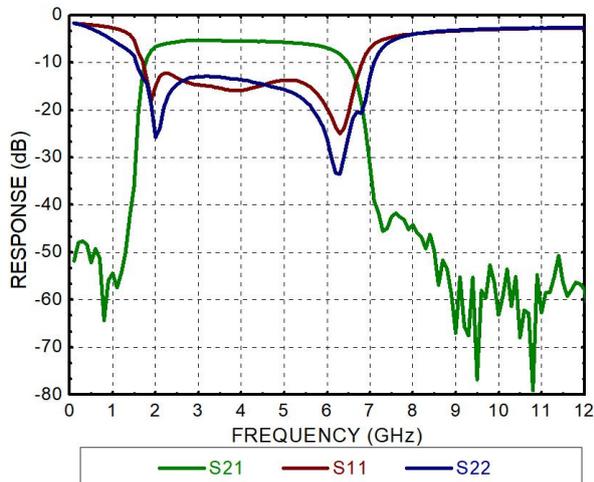
功能框图



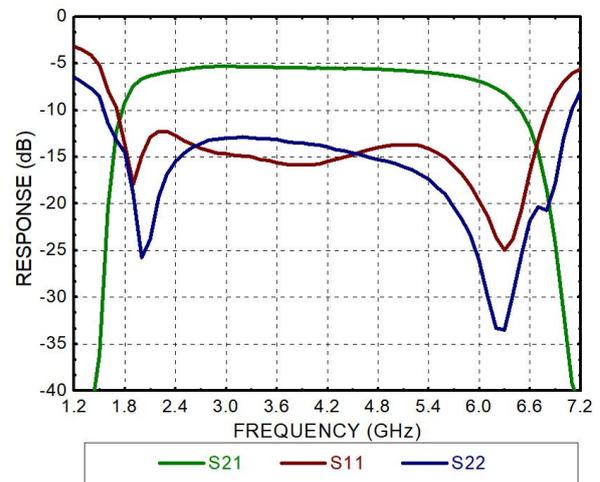
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$)

参数	2-6GHz	2.2-2.8GHz	2.7-3.7GHz	3.6-5.1GHz	5-5.9GHz	单位
插入损耗	7	7	6.5	6.5	7	dB
带内平坦度	1.6	1	0.8	1.2	1	dB
回波损耗	-15	-15	-15	-15	-15	dB
带外抑制	30@1.5GHz 25@7GHz	35@1.7GHz 32@3.5GHz	40@2GHz 30@4.6GHz	45@2.9GHz 30@6.1GHz	45@4.2GHz 30@6.9GHz	dBc

2-6GHz反射系数

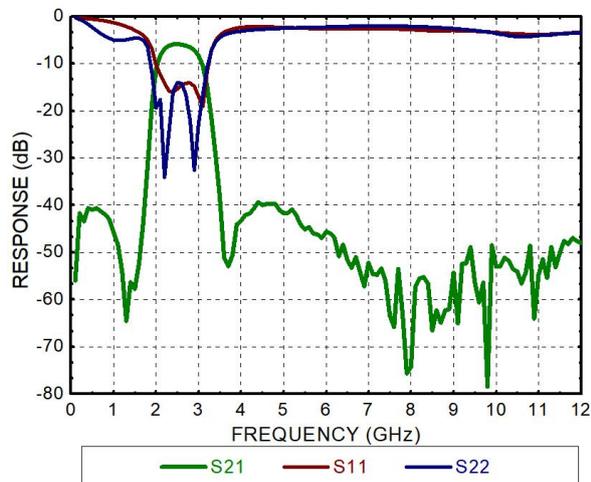


2-6GHz反射系数

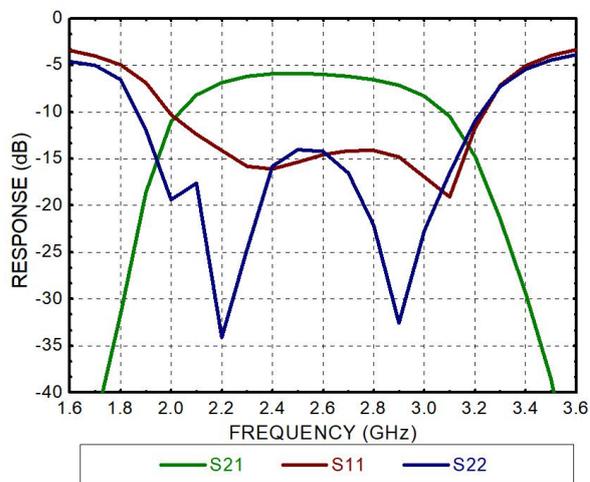




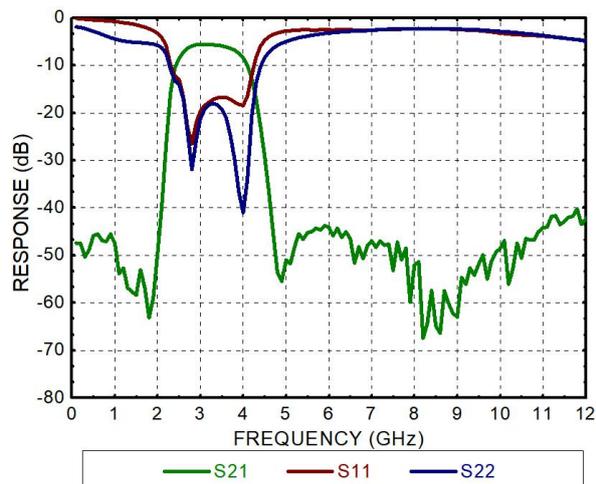
2. 2-2.8GHz反射系数



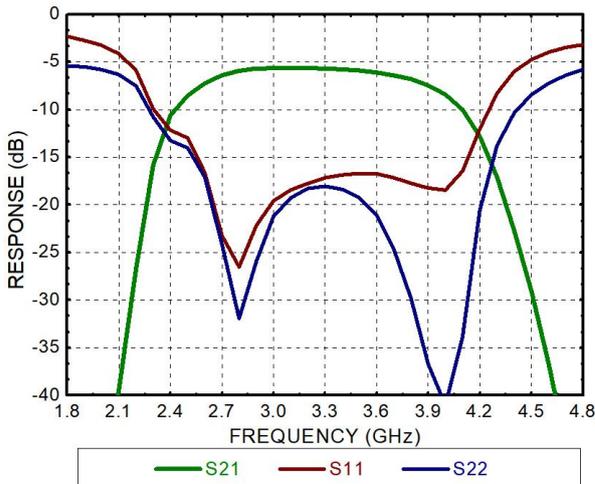
2. 2-2.8GHz反射系数



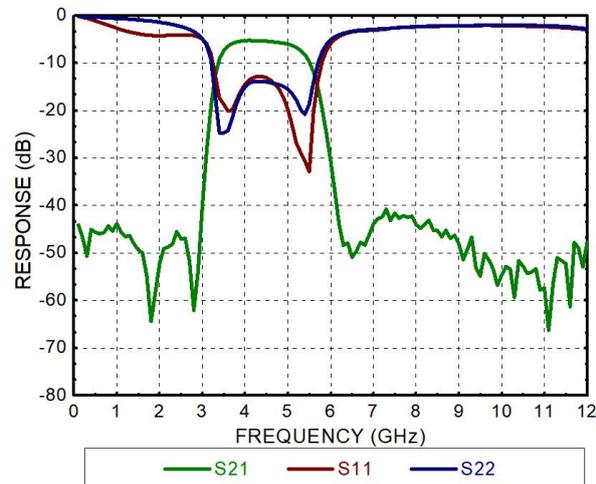
2. 7-3.7GHz反射系数



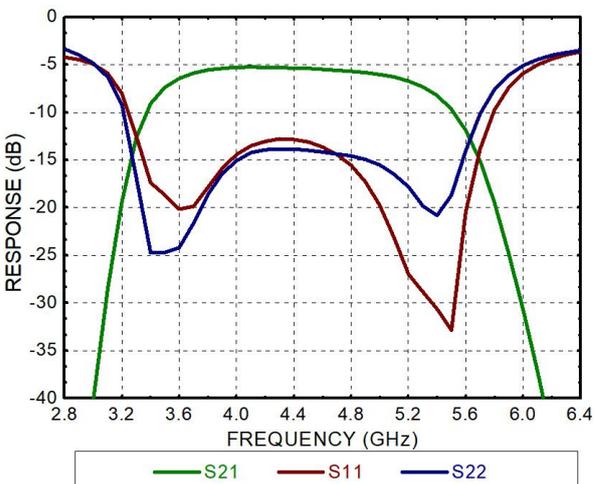
2. 7-3.7GHz反射系数



3. 6-5.1GHz反射系数

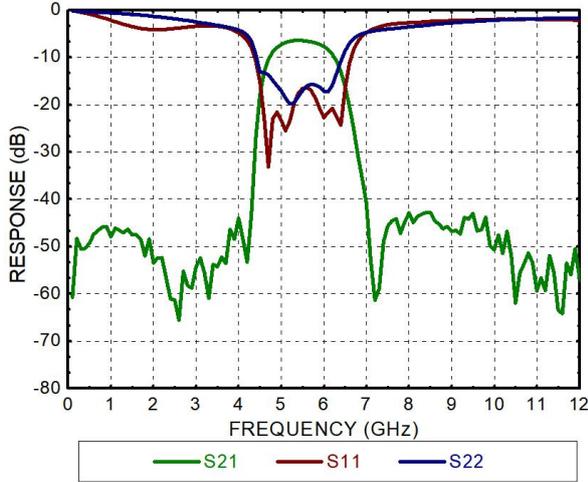


3. 6-5.1GHz反射系数

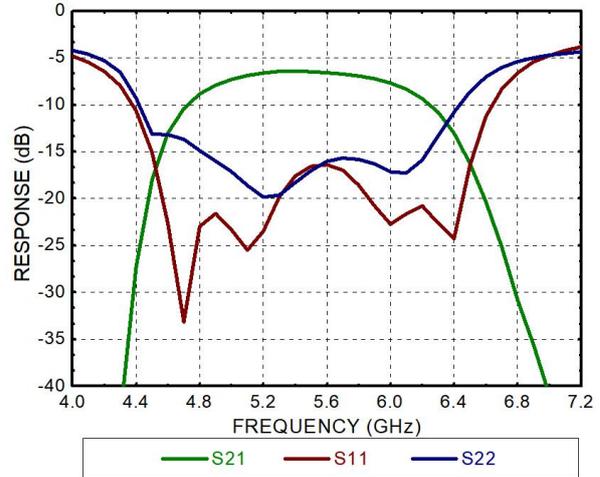




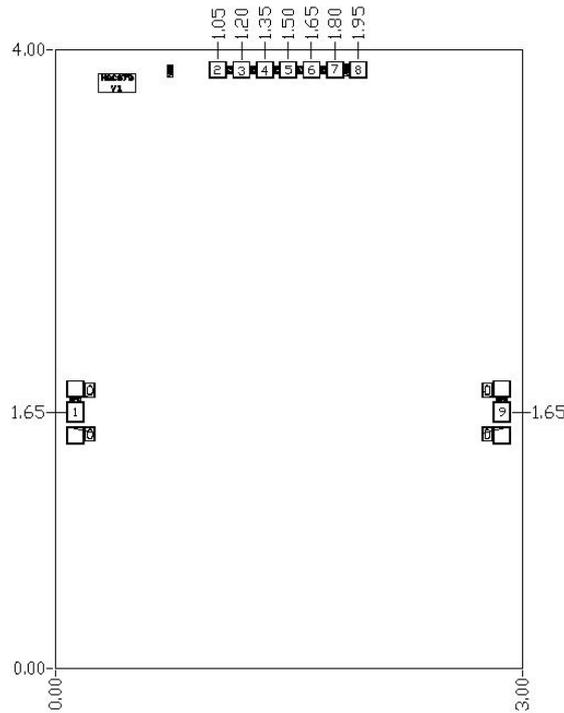
5-5.9GHz反射系数



5-5.9GHz反射系数



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1、9	RF1, RF2	该焊盘是 RF 信号输入输出端, DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
2、8	VEE	该焊盘是直流电源输入端, 使用时任选一端接-5V 电压
3-7	A1-A5	该系列焊盘为 0/+5V 控制电压输入端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

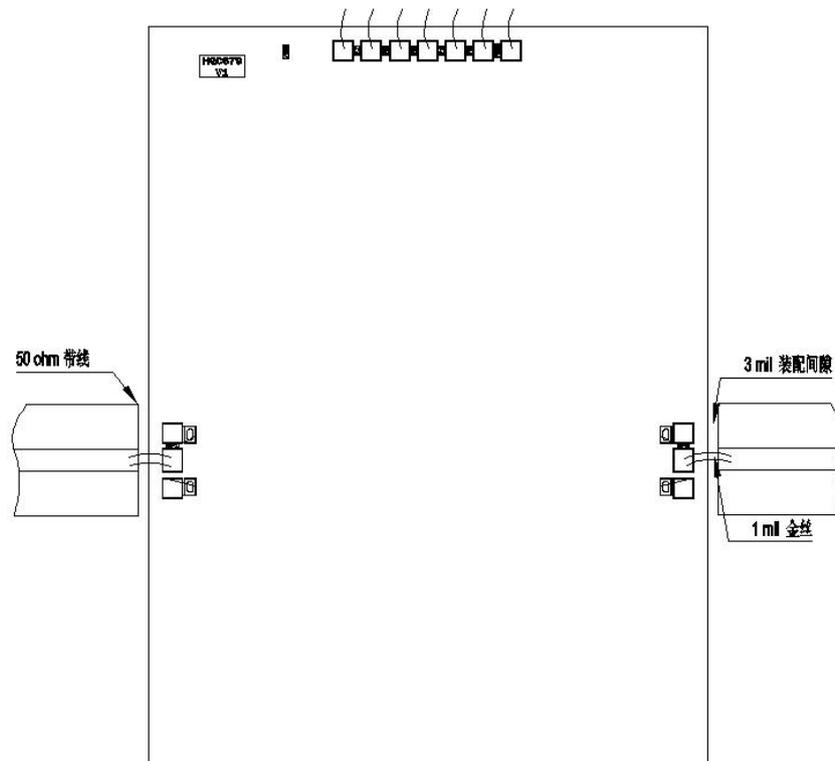


真值表

	A1	A2	A3	A4	A5
2-6	1	0	0	0	0
2.2-2.8	0	1	0	0	0
2.7-3.7	0	0	1	0	0
3.6-5.1	0	0	0	1	0
5-5.9	0	0	0	0	1

“0”电平范围：0~0.5V；“1”电平范围：3~5V

装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 120*100 μm^2
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压：-6 V
2. 射频输入功率：+27 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$